

# 環境負荷物質不使用証明書

日付 \_\_\_\_\_ 年 月 日

対象部材名 \_\_\_\_\_

会社名 \_\_\_\_\_

作成者氏名 \_\_\_\_\_

責任者氏名 \_\_\_\_\_ 印

- (1) 貴社に納品する上記対象部材(納入製品/部材/梱包資材含む)に表中の使用禁止物質の含有がない事を保証致します。  
 (2) 表中の全対象物質の含有有無についてはMSDSや成分表等による構成される成分情報により保証致します。  
 (3) RoHS規制物質については基準(閾値)を満たし、含有がない事をICP分析データ等により保証致します。

表1-1 使用禁止物質の用途と基準

(2017/02/01 改訂版)

No.	物質名	用途	基準(閾値)	
1	鉛及びその化合物	・樹脂、樹脂製品、及びその材料(ゴム、フィルム含む) ・顔料、塗料、インキ、染料、接着剤 ・包装材	意図的使用禁止 かつ、100ppm以下	
		鉛フリー はんだ	・棒はんだ・線はんだ・やに入りはんだ ・クリームはんだ・はんだボール	500ppm以下
			・買入基板のはんだ接合部 ・部品はんだめっき部(リード端子単体 などの溶融はんだめっき)	1,000ppm以下
			・フロー半田槽中の鉛フリーはんだ	800ppm以下
		金属めっき	・スズ系めっき部(溶融めっきを除く)	1,000ppm以下
			・スズ系めっき以外の金属めっき部 ・無電解Niめっき部	
		・上記以外のもの	意図的使用禁止 かつ、1,000ppm以下	
・半導体内部の高融点はんだ(鉛が85W%以上のはんだ) ・電子セラミック部品 ・ブラウン管、電子部品、蛍光管に使用されるガラス ・合金(鋼合金:0.35wt%以下、アルミニウム合金:0.4wt% 以下、銅合金、黄銅:4wt%以下)	適用除外			
2	水銀及びその化合物	・樹脂(ゴム、フィルム含む) ・顔料、塗料、インキ ・水銀電池 ・水銀を使用したリレー、スイッチ、センサー	意図的使用禁止 かつ、1,000ppm以下	
		・包装材	意図的使用禁止 かつ、100ppm以下	
		・上記以外のもの	意図的使用禁止 かつ、1,000ppm以下	
		・小型蛍光灯(1本当り5mg未満) ・一般照明用直管蛍光灯 ・ハロリン酸型(1本当り10mg未満) ・標準タイプトリリン酸型(1本当り5mg未満) ・超寿命タイプトリリン酸型(1本当り8mg未満) ・小型蛍光灯、直管蛍光灯以外のランプ	適用除外	
3	カドミウム及びその化合物	・樹脂、樹脂製品、及びその材料(ゴム、フィルム含む) ・顔料、塗料、インキ、染料、接着剤 ・表面処理、コーティング ・小型蛍光灯	意図的使用禁止 かつ、5ppm以下	
		鉛フリー はんだ	・棒はんだ・線はんだ・やに入りはんだ ・クリームはんだ・はんだボール ・買入基板のはんだ接合部 ・部品はんだメッキ部(リード端子単体)	20ppm以下

No.	物質名	用途	基準(閾値)	
3	カドミウム及びその化合物	金属めっき	・スズ系めっき部(溶融めっきを除く)	20ppm以下
			・スズ系めっき以外の金属めっき部	75ppm以下
			・無電解Niめっき部	
		・厚膜ペースト材料、抵抗体 ・亜鉛およびその合金(黄銅などを含む)	75ppm以下	
		・上記以外のもの	意図の使用禁止 かつ、75ppm以下	
		・包装材料	意図の使用禁止 かつ、100ppm以下	
		・高信頼性を要求される電気接点(代替できないもの)	適用除外	
4	六価クロム化合物	・包装材料 ・クロメート処理	意図の使用禁止 かつ、100ppm以下	
		・樹脂(ゴム、フィルム含む) ・顔料、塗料、インキ ・電池 ・触媒	意図の使用禁止 かつ、1,000ppm以下	
		・上記以外のもの	意図の使用禁止 かつ、1,000ppm以下	
5	ポリ臭化ビフェニール類 (PBB類)	・全用途 例えばプラスチック難燃剤	意図の使用禁止 かつ、1,000ppm以下	
6	ポリ臭化ジフェニルエーテル類 (PBDE類)	・全用途 例えばプラスチック難燃剤	意図の使用禁止 かつ、1,000ppm以下	
7	3置換有機スズ化合物 (トリブチルスズ(TBT)化合物) (トリフェニルスズ(TPT)化合物)	・全用途 例えば塗料、顔料、安定剤、防腐剤	意図の使用禁止 かつ、1,000ppm未満	
8	ジブチルスズ(DBT)化合物	・全用途 [以下の物質に含有の可能性有り] 樹脂安定剤、ポリウレタン用硬化触媒、シリコーン用 硬化触媒、ガラス被覆剤、ゴム用改質剤	1,000ppm未満	
9	ジオクチルスズ(DOT)化合物	・繊維、油の材料の添加剤 ・以下の用途に限定して禁止。 ・皮膚に触れる繊維 ・壁、フロアカバー ・2成分温室硬化モールドキット(RTV-2モールドキット)	意図の使用禁止 かつ、1,000ppm未満	
10	短鎖型塩化パラフィン(C10-13)	・全用途	意図の使用禁止	
11	ポリ塩化ナフタレン(塩素数が1以上)	・全用途	意図の使用禁止	
12	マイレックス	・全用途	意図の使用禁止	
13	ポリ塩化ビフェニール類(PCB類)	・全用途	意図の使用禁止	
14	ポリ塩化ターフェニル類(PCT類)	・全用途	意図の使用禁止 かつ、50ppm以下	
15	アスベスト類	・全用途	意図の使用禁止 かつ、1,000ppm以下	
16	特定のアミン化合物(※1)	・全用途	意図の使用禁止	
17	特定アミン(※2)を形成する アゾ染料・顔料	・人の皮膚または口腔に直接かつ長時間接触する 可能性のある織物、革製品 (例:衣類、寝具、手袋、腕時計バンド等)	特定アミンとして 30ppm以下	
18	オゾン層破壊物質	・冷媒・断熱材等の製品に搭載する用途	意図の使用禁止	
19	ハイドロクロロフルオロカーボン (HCFC)	・全用途 例) 冷媒、発泡剤、実装基板の洗浄剤等	意図の使用禁止	

No.	物質名	用途	基準(閾値)
20	ハイドロフルオロカーボン(HFC) パーフルオロカーボン(PFC) 六フッ化硫黄(SF6)	・全用途 例) 冷媒・断熱材等の製品に搭載する用途	意図的使用禁止
		・プロジェクター用電源ユニットのサーミアブソーバー への使用される六フッ化硫黄	適用除外
21	放射性物質	・全用途	意図的使用禁止
22	ベンゼン	・全用途	意図的使用禁止
23	ホルムアルデヒド	・パーティクルボード、MDF(中密度繊維板)等を用いた 木工の製品及び部品	気中濃度 0.1ppm以下 0.15mg/m <sup>3</sup> 以下
24	ヘキサクロロベンゼン	・全用途	意図的使用禁止
25	特定ベンゾトリアゾール	・全用途 例えば樹脂の紫外線吸収剤	意図的使用禁止
26	パーフルオロオクタンスルホン酸 およびその塩(PFOS)	・全用途	意図的使用禁止 かつ、 半製品、成形品、部品： 1,000ppm以下 表面処理：1μg/m <sup>2</sup> 以下
		・フトリソグラフィープロセス用のフォトレジスト ・フィルム、紙、印刷原版用の写真コーティング剤	適用除外
27	ジメチルフマレート	・全用途 例えば防湿剤、防カビ剤	意図的使用禁止 かつ、0.1ppm以下
28	塩化コバルト(Ⅱ)	・全用途 例えば乾燥材に使用される湿度表示薬、インジケータ	意図的使用禁止
29	多環芳香族炭化水素(PAH)	・皮膚または口腔内に直接、長時間または短時間で 繰り返し接触するゴムまたはプラスチック部品。	1ppm以下
30	ヘキサブロモシクロデカン (HBCDD)	・全用途	意図的使用禁止 かつ、1,000ppm以下
31	ベンゼンアミン、N-フェニル、 スチレンおよび2,4,4トリメチル ペンテンとの反応生成物(BNST)	・全用途	意図的使用禁止
		・ゴム中の添加剤(タイヤは除く)	適用除外
32	ポリ塩化ビニル(PVC)および その混合物	・適用除外に示す用途以外の下記の用途でポリ塩化ビニル の使用を制限する。 (1)電気・電子機器の新製品における機器 内部配線。 (2)製品および製品に同梱されるアクセサリ等に 用いられる包装材 なお、使用制限となる個々の部品、材料は、当社 要請に基づき対応のこと。 ただし、ポリ塩化ビニル代替材料はハロゲンフリー (フッ素を除く)であることを原則とする。 なお、難燃剤として赤リンを使用する場合には、 製品安全上の基準に適合すること。 ※ただし、EU RoHS 指令において機器として 扱われるケーブルを除く。 ・非接触IC カード(FeliCa)用基材 ・キャリングバッグ等の生地およびコーティング剤 ・アクセサリ、接続コード等を束ねる結束バンド ・部品に用いられる包装部品・材料 (トレイ、マガジン、ストッパ、リール、エンボス、 キャリアテープなど)を除く ・熱収縮チューブ ・フレキシブルフラットケーブル(FFC) ・絶縁板、化粧板、ラベル ・シート、ラミネート ・車載機器取付け用吸着盤	意図的使用禁止
		・安全性など品質が保てない場合、調達面で困難な 場合、法規制などで材料が指定されている場合、 お客様から材料指定された場合等 ・塗料、インキ、コーティング剤、接着剤等に用いられる 樹脂用結着剤(バインダ)	適用除外

No.	物質名	用途	基準(閾値)
33	フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)	・適用除外に示す用途以外の全用途 例)ゴム、エラストマー、 樹脂(特にポリ塩化ビニル)用可塑剤	2018年7月22日以降禁止
34	フタル酸ブチルベンジル(BBP)	・適用除外に示す用途以外の全用途 例)ゴム、エラストマー、 樹脂(特にポリ塩化ビニル)用可塑剤	2018年7月22日以降禁止
35	フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)	・適用除外に示す用途以外の全用途 例)ゴム、エラストマー、 樹脂(特にポリ塩化ビニル)用可塑剤	2018年7月22日以降禁止
36	フタル酸ジイソブチル(DIBP)	・適用除外に示す用途以外の全用途 例)ゴム、エラストマー、 樹脂(特にポリ塩化ビニル)用可塑剤	2018年7月22日以降禁止
37	その他の有機臭素系化合物	・積層プリント配線基盤に用いられる難燃剤用途	900ppm以下
		・上記以外のプラスチック部品の難燃剤	意図的使用禁止
38	リン酸トリス(2-クロロエチル)(TCEP)、 リン酸トリス(1-メチル-2-クロロエチル)(TCPP) リン酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)(TDCPP)	・プラスチック、樹脂、繊維、布材料への難燃剤用途	1,000ppm以下
39	過塩素酸塩	・全用途	0.006ppm以下
15	その他の有機塩素系化合物	・積層プリント配線基盤に用いられる難燃剤用途	900ppm以下
		・上記以外のプラスチック部品の難燃剤	意図的使用禁止
40	パーフルオロオクタン酸(PFOA)、 その塩及びそのエステル	・繊維、布材料、布皮材料へのコーティング剤 ・フィルム・紙・印刷版への写真用コーティング剤	コーティングされた材料に対して $1 \mu\text{g}/\text{m}^2$ 以下
		・半導体中に用いられる接着剤・ホイル・テープへの添加剤	1,000ppm以下
41	酸化ベリリウム銅	・全用途	意図的使用禁止
42	ベリリウム銅	・全用途	意図的使用禁止
43	三酸化二ヒ素、五酸化二ヒ素	・液晶パネル(カバーガラス、タッチパネル、バックライト含む)のガラスの消泡剤、清澄剤の用途	1,000ppm以下
44	フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)、 フタル酸ジブチル、 フタル酸ブチルベンジン、 フタル酸ジイソブチル	・全用途	1,000ppm以下
		・デバイス、半導体およびその他部品に用いられる 包装部品・材料への添加剤	適用除外
45	フマル酸ジメチル(DMF)	・全用途	0.1ppm以下
46	ホウ酸、特定ホウ酸ナトリウム	・全用途	1,000ppm以下
47	4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール	・全用途	1,000ppm以下
48	ビス(2-メトキシエチル)エーテル	・全用途	1,000ppm以下
49	N,N-ジメチルアセトアミド(DMAC)	・全用途	1,000ppm以下
50	エチレングリコールジメチルエーテル(EGDME)	・全用途	1,000ppm以下
51	リン酸トリキシリル(TXP)	・全用途	1,000ppm以下

☆包装材料：カドミウム、鉛、水銀、六価クロムの4重金属総量で、部位ごとに100ppm未満。但し、カドミウムは5ppm未満。

表中の(※1)及び(※2)の特定のアミン化合物の詳細は、弊社発行のグリーン調達ガイドライン(第3版)を参照の事。

FPC-17104